

<<微电子设备与器件封装加固技术>>

图书基本信息

书名：<<微电子设备与器件封装加固技术>>

13位ISBN编号：9787118040579

10位ISBN编号：7118040576

出版时间：2005年09月

出版时间：国防工业出版社

作者：杨平

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>